

# IC

All lineup of our products, The world knows that.



>>BESTEM-D01/R

>>BCOS-IV

## Front End ▶▶▶

	ダイボンディング Die Bonding	キュア Curing
SOP/TSOP TSSOP/MMIC	<b>BESTEM-D01/R</b> フレキシブルエポキシダイボンダー Flexible Epoxy Die Bonder ・実装スピード 0.18秒 ・Mounting Speed 0.18 sec ダイボンダー Die Bonder	
COMMON	<b>BESTEM-D02</b> φ300ダイボンダー φ300 Die Bonder ・φ12インチ対応 UPH10000を実現 ・For φ12 inch, achieved UPH10000 ダイボンダー Die Bonder <b>ニードルレスピックアップ技術</b> Needleless pick up technology	<b>BCOS-IV</b> インラインキュア炉 In-Line Curing Oven ・均一加熱、クリーンキュア (品種切換マニュアル) ・Even heating, clean cure(Manual conversion) キュア Curing
BGA/CSP		
COMMON		
FC-BGA CSP	<b>CPM-7000</b> Series フリップチップダイボンダー Flip Chip Die Bonder ・超音波接合・熱圧着 選択可 ・For ultrasonic bonding or thermo compression bonding ダイボンダー Die Bonder	



>>CAP-3500

>>MACS-300

**Back End** ▶▶▶

切断 Cutting	洗浄 Rinsing	成形 Forming	測定 Testing	捺印 Marking	検査 Inspecting	テーピング Taping
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------------------	-----------------

**FLAG-300** フレキシブルレーザーグラフ  
Flexible Lazer Graph

- ・CSP, BGAフレームにも対応
- ・Prepared for CSP and BGA frame

捺印  
Marking

**SDM Series** シングレーションマシン Singulation Machine

- ・ウエハー、基板の切断・洗浄・検査・挿入
- ・Cutting, rinsing, inspecting, and inserting wafer and board.

切断 Cutting    洗浄 Rinsing    検査 Inspecting

**MACS-300 Series** リードレスマルチバックエンドシステム Leadless Multi Back-End System

- ・ダイシングテープよりピックアップ 0.3秒/個の高速処理
- ・High-speed pick up process 0.3 sec/work through dicing

測定 Testing    捺印 Marking    検査 Inspecting    テーピング Taping

Test Mapping

- CAP-300II** **ダイスピッカー** Die Sorter

  - ・φ8インチウエハー、4インチトレイに対応
  - ・For φ8 inch wafer and 4 inch tray

ニードルレスピックアップ技術  
Needleless pick up technology
- CAP-3000II** **ダイスピッカー** Die Sorter

  - ・φ12インチウエハー対応
  - ・For φ12 inch wafer

ニードルレスピックアップ技術  
Needleless pick up technology
- CAP-400II** **パッケージピッカー** Package Sorter

  - ・反転挿入で0.5秒、ダイサーとのインライン接続可能
  - ・Rotate insertion of 0.5 sec, In-line connection with dicer

ニードルレスピックアップ技術  
Needleless pick up technology
- CAP-3500** **ダイスピッカー** Die Sorter

  - ・φ12インチウエハーからφ8インチリング、トレイへ
  - ・φ12 inch wafer to φ8 inch ring, tray

ニードルレスピックアップ技術  
Needleless pick up technology
- CAP-500** **ダイスピッカー** Die Sorter

  - ・φ8インチウエハー、テープ収納
  - ・For φ8 inch wafer and taping

テーピング Taping    ニードルレスピックアップ技術  
Needleless pick up technology